

LP TechShield Protec

OSB ESTRUTURAL COM BARREIRA RADIANTE

PARA VERÕES MAIS FRESCOS E INVERNOS MAIS QUENTES



TECNOLOGIA ANTIMICROBIANA



- ✓ Placa estrutural OSB que integra uma barreira radiante de alumínio numa das faces.
- ✓ Reflete a radiação térmica, reduzindo a temperatura na área do telhado da casa.
- ✓ Inclui a tecnologia Copptech, que elimina cupins, bactérias e vírus, inclusive o Covid-19.

www.LPChile.cl



Panel estrutural OSB que integra uma barreira radiante de alumínio com incisões numa das faces, criado para melhorar a eficiência energética da casa e o conforto habitacional, aplicando a tecnologia LP ao investimento atual e futuro.

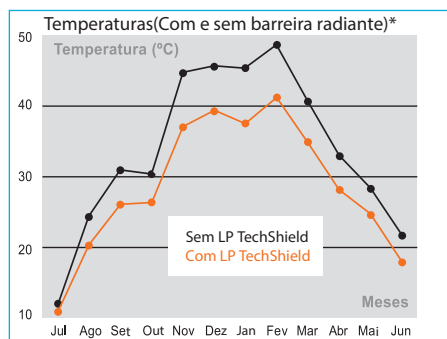
LP TechShield Protec é uma placa com certificação estrutural APA, o que garante sua qualidade de acordo com os padrões exigidos na América do Norte. Sua utilização é para construções residenciais em telhados, pisos e paredes, constituindo parte importante do sistema Construtivo de Energia Assísmica (C.E.A.).

Tabela de Dimensões

FORMATOS 1,22 X 2,44 m			
	Pallet	Peso	
Producto	Peso (kg)	(Unidades)	Pallet (kg)
TechShield 11,1 mm	22,5	72	1.618
TechShield 15,1 mm	30,6	53	1.620

Atributos

- Reflete 97% da radiação térmica.
- Reduz a temperatura do sótão em até 24% (aprox. 48° C a 36° C).
- As incisões na chapa de alumínio permitem a evacuação do vapor de água.
- A integração da barreira no quadro permite otimização de mão de obra, para instalação mais rápida que ambos os produtos separadamente (economia no local).
- Otimiza a mão de obra aumentando a velocidade de instalação e reduzindo a perda de material.
- Sua instalação não requer ferramentas ou produtos especiais.



Tecnología

As pacas estruturais **LP TechShield Protec** incorporam perfurações que permitem o fluxo de um lado para o outro, liberando a umidade quase tão rapidamente quanto uma placa LP OSB tradicional. O uso de barreiras contínuas contra radiação pode reter a umidade do sótão e impedir sua liberação.

Emitância (emissividade)

Todos os materiais têm emissividades que variam de zero a um. Quanto menor a emissividade de um material, menos calor é irradiado dessa superfície (energia radiante infravermelha). O **LP TechShield Protec** possui baixíssima emissividade de 0,03, o que explica seu uso como barreira radiante.

Refletância (refletividade)

Refere-se à fração da energia radiante recebida que é refletida na superfície. Tanto a refletividade quanto a emissividade estão relacionadas, portanto, uma baixa emissividade é um indicador de uma superfície altamente refletiva. Neste caso, o **LP TechShield Protec** possui refletividade de 0,97.

Armazenamento

Armazene em local limpo e seco. Não armazene em contato direto com o solo. Proteja da umidade antes e durante a instalação. Na parte externa deverão ser cobertos com plástico ou lona encerada, permitindo ventilação pelas laterais. Manuseie de forma semelhante a outros produtos de revestimento LP. Não deixe cair nos cantos nem quebre as bordas das placas. Manuseie a superfície da chapa metálica da barreira radiante com cuidado, para não danificá-la.

A placa deve atingir a umidade de equilíbrio antes da instalação. Deve ser climatizada no local onde será instalada, seja travando-as ou apoiando-as implantadas em uma parede para que cada placa absorva individualmente a umidade ambiente. Quando o teor de umidade estiver acima da umidade de equilíbrio do local de uso e portanto deverá ser seco para diminuir a umidade da placa.

Instalação de telhado

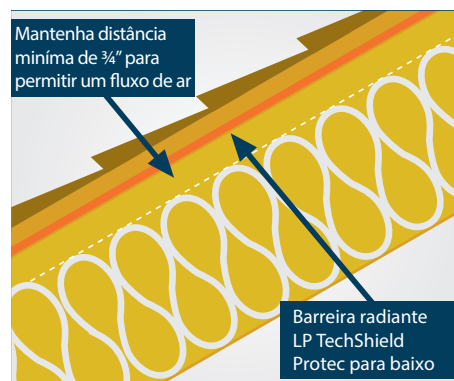
Verifique se o alinhamento das vigas ou soleiras é uniforme.

Forneça ventilação adequada ao telhado de acordo com o código de construção da sua área.

Coloque as tábuas com a chapa metálica voltada para baixo no telhado.

Proteja-os da umidade antes e durante a instalação.

Instale todas as placas com as marcações de revestimento APA, LP e TechShield voltadas para baixo.



Proteger as placas **LP TechShield Protec** de umidade antes e durante a instalação. Se as placas forem armazenadas ao ar livre, deverão ser cobertas com polietileno ou lona encerada, permitindo ventilação pelas laterais.

Instalação na parede

Na aplicação em parede, a face com a superfície metálica deve ficar voltada para o exterior da casa. A placa **LP TechShield Protec** não substitui a barreira de vapor.

Lembre-se de deixar beirais e cumeeiras ventilados para maximizar a eficácia da barreira radiante, mantendo assim um ambiente mais seco e saudável no interior da casa.



SEM LP TECHSHIELD PROTEC

A radiação infravermelha penetra na cobertura do telhado.

Os ambientes em contacto com o telhado são quentes e apresentam baixo conforto térmico.

Maior consumo de energia para ar condicionado.



COM LP TECHSHIELD PROTEC

97% da recepção infravermelha é refletida no exterior.

A temperatura do teto é reduzida em até 24%.

As moradias são mais frescas no verão e menos frias no inverno.

Reduz o consumo de energia no aquecimento e, sobretudo, no ar condicionado, gerando também poupanças a longo prazo.